Добро пожаловать в О-ведущую

Мы являемся профессиональными производителями печатных плат с более чем десятилетним опытом работы. Ассортимент продукции: односторонняя, двухсторонняя, многослойная печатная плата, гибкая печатная плата и МСРСВ. Мы можем обеспечить быстрое прототипирование: S / S за 24 часа, 4-8 единиц за 48-96 часов производства. (поставщик печатных плат)

Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, мин .020 .. Отверстия не могут быть соединены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленкой, 25 штук / пакет, положить осушитель сбоку, положить индикатор влажности на верхнюю сторону

Описание продукта

PCB P / N	LE-150
Подсчет слоев	1L
материал	Основная керамика
совет директоров	3,2 мм
медь	1 унция
Наименьший размер отверстия	/
Количество отверстий (штук)	/
линия с	/
Проверка импеданса S / N (Tol%)	N
Чистота поверхности	ENIG (Au: 0,05 мкм)
Шелкография сварочной маски	Черно-белый
Одиночные размеры	Дим х (мм): 27; Дим Ү (мм): 45
Panelisation	Дим х (мм): 27; Тусклый Ү (мм): 135; ИБП № 3
Специально: отрывная маска	N
Маршрутизация / Штамповка	Винт с потайной головкой с ЧПУ +

•

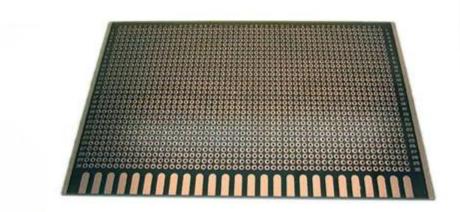












www.o-leading.com

Наша команда



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT













Сертификаты







Test Report

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO., LIMITED

No. SZXEC1900530401

1313,FLOOR 13, FORTUNE BUILDING, DANSHUI TOWN, HUIYANG DISTRICT, HUIZHOU, GUANGDONG, CHINA

Date: 30 Mar 2019 Page 1 of 6

Test Report No. SZXEC1900530401 Date: 30 Mar 2019 Page 2 of 6

Test Results :

Test Part Description :

 Specimen No.
 SGS Sample ID
 Description

 SN1
 SZX19-005304.001
 Green*PCB**

(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% (2) MDL = Method Detection Limit

(3) ND = Not Detected (< MDL)

(4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method : With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC682321-5:2013, IEC62321-7:2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	001
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	8
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (Cr(VI))	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1.000	mg/kg		ND
Monobromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	12	mg/kg	5	ND
Tribromobiphenyl	15	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	6	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl		mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg		ND
Monobromodiphenyl ether		mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	12	mg/kg	5	ND
Tribromodiphenyl ether	2	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether		mg/kg	5	ND



in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service as for accessible at high civere ass convent forms and Conditions again and for electronic ternal doc fishors for Electronic Documents is inter/investage.com/lent ferms end-Conditions[Ferms-e]-Documents missiants of labelity, independentation and jurisdiction insues defined therein, any folder of this docu-

- Remark (14.0 post-times-days-scene)
(2586g to 4.1 post-times-form) (14.0 post-times-for

Member of the SGS Group (SGS SA)

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as : OSP

SGS Job No. : RP19-005089 - SZ Date of Sample Received : 22 Mar 2019

22 Mar 2019 - 30 Mar 2019 Testing Period :

Test Requested : Selected test(s) as requested by client. Test Method Please refer to next page(s).

Test Results : Please refer to next page(s).

Conclusion:

Based on the performed tests on submitted sample(s), the results of Lead. Mercury, Cadmium, Hexavalent chiromium, Polybrominated biphenyls (PBBs), Polybrominated diphenyl ethers (PBBcs) and Phthalates such as Bis(2-ethylbexyl) phthalate (DBFP). Bibutyl phthalate (DBFP). Tolbutyl phthalate (DBFP), and Diisobutyl phthalate (DBFP) comply with the limits as set by RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/85/EU.

Signed for and on behalf of SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Shenzhen Branch

lina

Tina Fan Approved Signatory



Max

Max

UL Product iQ™



ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

Cond Width

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F TAI SANG BANK BLDG 130-132 DES VOEUS ROAD CENTRAL, HONG KONG

		Min	Cond	SS/	Area	Solo	der	Oper		Meets	c
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Lim	its	Temp	Flame	UL796	T
Type	mm(in)	mm(in)	mic(mil)	DSO	mm(in)	c	sec	c	Class	DSR	1
Multilayer (m	Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.										
O-LEADING- 401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	3	50
O-LEADING- 407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-
Multilayer pri	nted wiring bo	ards.							3		
O-LEADING- 408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer p	rinted wiring b	oards.							3 77	7.57	
O-LEADING- 002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING- 003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	A	-
O-LEADING- 033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	*
O-LEADING- 205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING- 206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING- D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING- S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING- S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	НВ	A	*
O-LEADING- S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

 $[\]mbox{\ensuremath{\star}}$ - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL 跟踪检验服务的要求。只有带有 UL 标志的产品,才应该被视为经过UL认证,并满足UL 跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件: 1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证(文件)必须在不篡攻任何数据(或图纸)的情况下完整且无误导性地呈现。2."经 UL 允许从在线认证目录转载"声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外,转载材料必须包含以下格式的版权声明:"© 2019 UL LLC"

Упаковка и доставка

Shipping service











	Quick Turn Lead Time					
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement				
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours				
4L	3-4days	48 Hours				
6L	4-5days	72 Hours				
8L	5-6days	NA				
10L	6-7days	NA				
12L	7-8days	NA				
14L	8-9days	NA				

	Standard Lead Time						
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time					
2L	4 days	10 days					
4L	5 days	11 days					
6L	6 days	12 days					
8L	8 days	14 days					
10L	10 days	16 days					
12L	12 days	18 days					
14L	14 days	20 days					
16-32L	18 days	24 days					

Возможность процесса

Возможности производства печатных плат

Количество слоев: 1Layer-32Layer

Толщина готовой меди: 1/3 унции-12 унций

Минимальная ширина линии / расстояние внутри: 3,0 мил / 3,0 мил

Минимальная ширина линии / расстояние между внешними: 4,0 мил / 4,0 мил

Максимальное соотношение сторон: 10: 1

Толщина доски: 0,2 мм-5,0 мм

Максимальный размер панели (дюймов): 635 * 1500 мм Минимальный размер просверленного отверстия: 4 мил

Допустимое отверстие в отверстии: +/- 3 мил

Blind / Buried Vias (All Types): ДА

Через заполнение (проводящий, непроводящий): ДА

Материал основания: FR-4, FR-4, высокая Tg. Безгалогеновый материал, Rogers, Алюминиевая основа,полиимида,

Тяжелая медь

Поверхностная обработка: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, серебро с примесьюолово Immersion, золотые пальцы, чернила углерода

Возможности производства SMT

Материал печатной платы: FR-4, CEM-1, CEM-3, алюминиевая плата

Максимальный размер печатной платы: 510х460 мм Минимальный размер печатной платы: 50х50 мм

Толщина печатной платы: 0.5mm-4.5mm

Толщина доски: 0,5-4 мм

Минимальный размер компонентов: 0201

Компонент стандартного размера чипа: 0603 и больше

Максимальная высота компонента: 15 мм

Минимальный шаг подачи: 0,3 мм

Мин BGA шаг шага: 0,4 мм

Точность размещения: +/- 0,03 мм